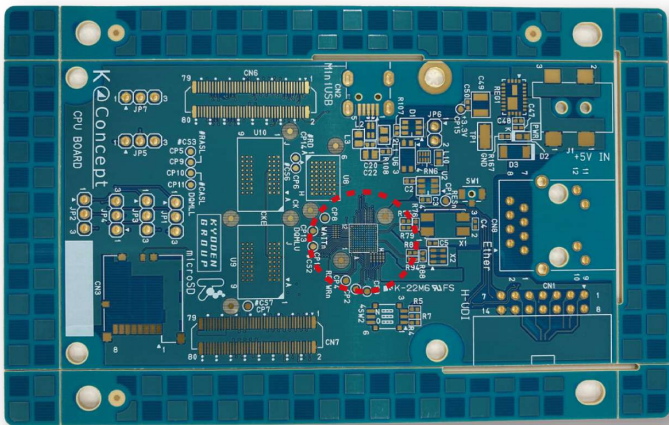


極小部品対応 ビルドアップ基板

K-Concept Ver.2

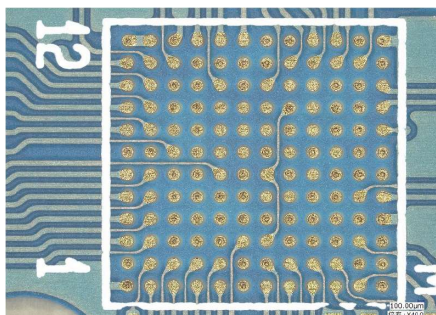
0.4mmピッチBGA、「0201」SMDチップ対応 6層(2-2-2)



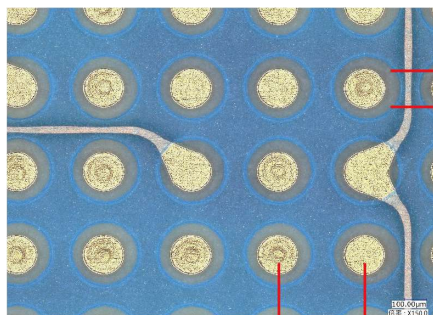
使用材料(コア/プリプレグ)

L1	プリプレグ R-5670NC 0.06
L2	プリプレグ R-5670NC 0.06
L3	コア R-5775KH 0.75 (18/18)
L4	プリプレグ R-5670NC 0.06
L5	プリプレグ R-5670NC 0.06
L6	プリプレグ R-5670NC 0.06

0.4mmBGA部(赤枠部拡大)



BGA PAD部

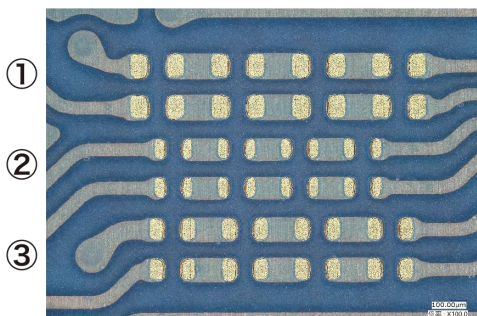


$\Phi 200 \mu\text{m}$

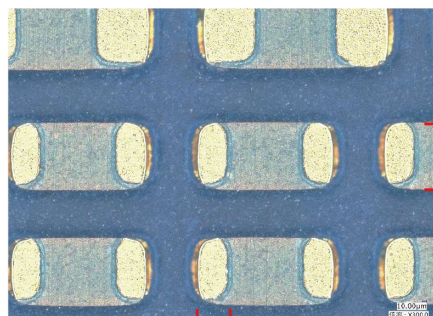
PAD径 : $\Phi 200 \mu\text{m}$
 SR開口径 : $\Phi 275 \mu\text{m}$
 PAD間L/S: $50/75 \mu\text{m}$

0.40 mm

「0201」SMD(赤枠部拡大)



PAD部(拡大)



② PAD: $120 \times 175 \mu\text{m}$

① PAD: $170 \times 195 \mu\text{m}$ SR開口: $120 \times 145 \mu\text{m}$
 ② PAD: $120 \times 175 \mu\text{m}$ SR開口: $70 \times 95 \mu\text{m}$
 ③ PAD: $145 \times 185 \mu\text{m}$ SR開口: $95 \times 135 \mu\text{m}$

② SR開口: $70 \times 95 \mu\text{m}$



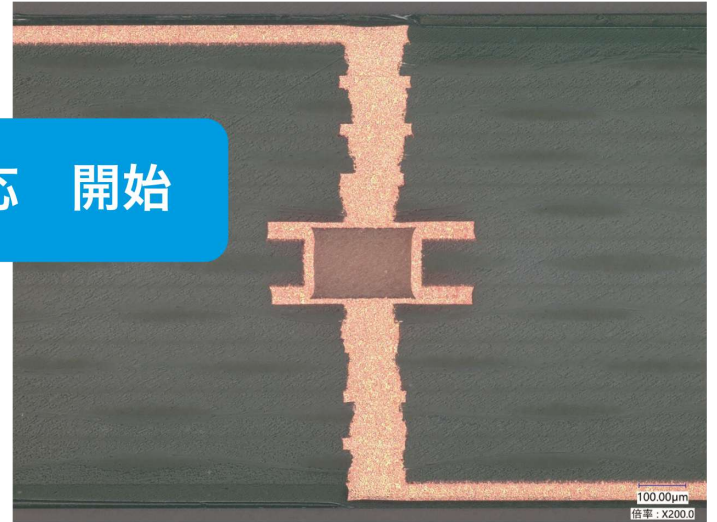
多段ビルドアップ基板

製造事例

4段 10層(4-2-4)フルスタック・貫通TH混在ビルドアップ基板



量産対応 開始



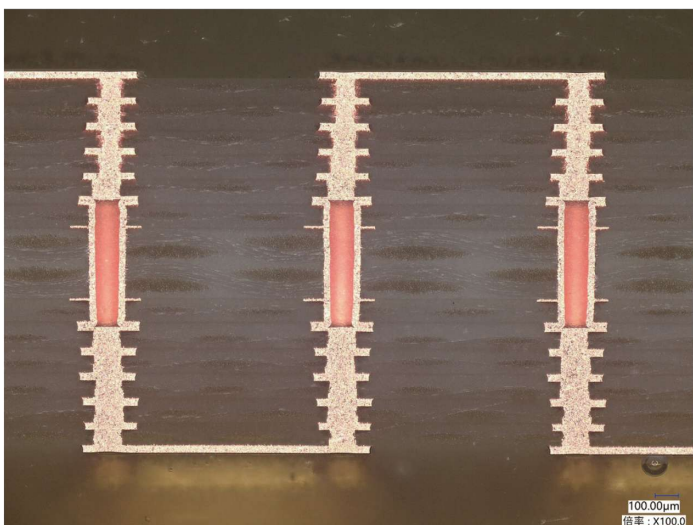
材料:Panasonic R-1566/R-1551

仕様:LVH径 $\Phi 0.08\text{mm}$ /RND径 $\Phi 0.14\text{mm}$ 貫通TH径 $\Phi 0.30\text{mm}$ /RND径 $\Phi 0.60\text{mm}$
Min.L/S=0.075/0.075mm

【自社信頼性評価試験 合格】

開発事例

5段 14層(5-4-5)フルスタックビルドアップ基板



開発中

材料:Panasonic R-1566/R-1551

仕様:LVH径 $\Phi 0.08\text{mm}$ /RND径 $\Phi 0.25\text{mm}$
Min.L/S=0.075/0.075mm